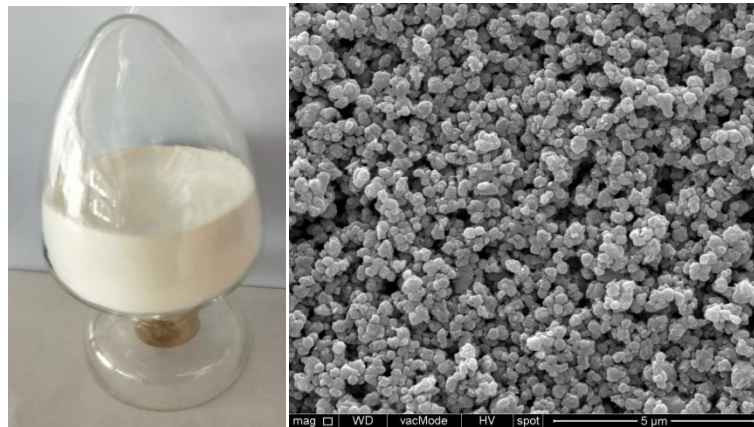


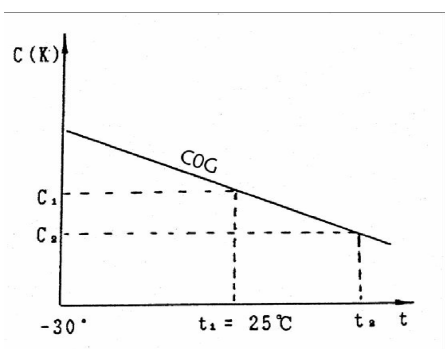
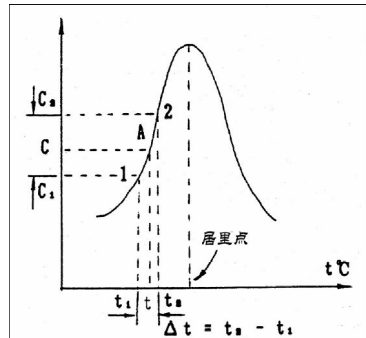
■ MLCC 用陶瓷介质材料

◆ 特性

- * 介质材料（配方粉）是制作多层陶瓷电容器（MLCC）的关键基础材料，作介质层用。
- * 我司采用固相法合成 BT 为主体系。固相法 BT 相比水热法，在可靠性上更有优势。
- * 我司已建成全国首条电子陶瓷粉体自动化生产线，实现了粉体生产的自动化和生产过程的数字化管理，提高了产品质量的稳定性。

◆ 产品图片



| | | |
|-------------|--|--|
| <p>温度特性</p> |  <p>容量随温度线性变化</p> |  <p>容量随温度非线性变化</p> |
| <p>瓷料类型</p> | <p>NPO (COG)</p> | <p>X7R、Z5U、Y5V</p> |

◆ 物理性能

| 型号 | 比表面积 (m ² /g) | K 值 | 介电损耗 DF (×10 ⁻⁴) | TCC | 烧结温度 (°C) | 适用 MLCC 流延膜厚 (μm) | 浆料 类型 |
|-----------|-----------------------------|----------|---------------------------------|-----|--------------|----------------------|----------|
| FW-K30N | 6.0±1.0 | 34±1.5 | ≤5 | NP0 | 1260~1300°C | ≥6 | BME |
| FW-K15 | 5.0±0.5 | 15.1±0.5 | <6 | NP0 | 1110~1130°C | ≥6 | NME |
| FW-K85 | 5.0±0.5 | 75±3 | <5 | NP0 | 1015~1045°C | ≥6 | NME |
| FW-B302A | 2.5±0.3 | 2600±200 | <80 | X7R | 1100~1140 | ≥10 | NME |
| FW-B292NA | 8.0±1.0 | 2300±100 | ≤75 | X7R | 1280±20 | ≥6 | BME |

| 型号 | 比表面积 (m ² /g) | K 值 | 介电损耗 DF (×10 ⁻⁴) | TCC | 烧结温度 (°C) | 适用 MLCC 流延膜厚 (μm) | 浆料 类型 |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------------------------|-----|--------------|----------------------|----------|
| FW-B332NA | 4.0±0.5 | 2850±200 | ≤75 | X7R | 1280±20 | ≥10 | BME |
| FW-B332NC | 3.5±0.5 | 2850±200 | ≤75 | X7R | 1280±20 | ≥8 | BME |
| FW-Y143NA | 6.0±0.5 | 12000±1500 | ≤45 | Y5V | 1220±10 | ≥6 | BME |

◆ **产品特点**

*本公司一直致力于高可靠、更安全、环保、小型化、薄层化的 MLCC 介质材料研发与生产，可提供 C0G、X7R、Y5V 等全系列 MLCC 介质材料，持续满足顾客对 MLCC 介质材料薄层化、高可靠、高性价比的需求。